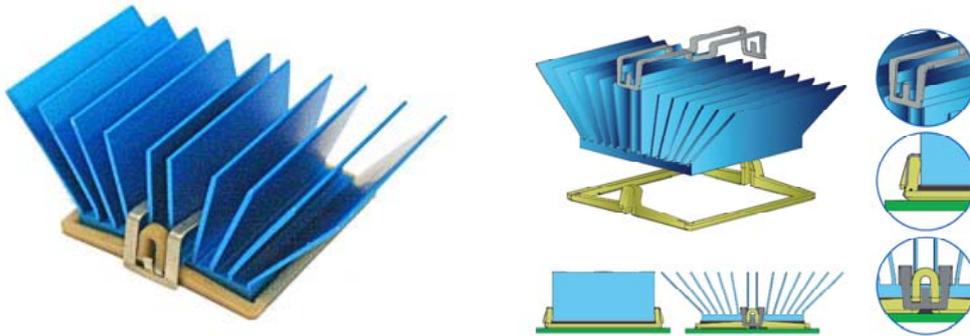


新提案！！ クリップ取付け型ヒートシンク

マキシフローHeat Sink スーパーグリップ型クリップアタッチメント方式

主な特徴：

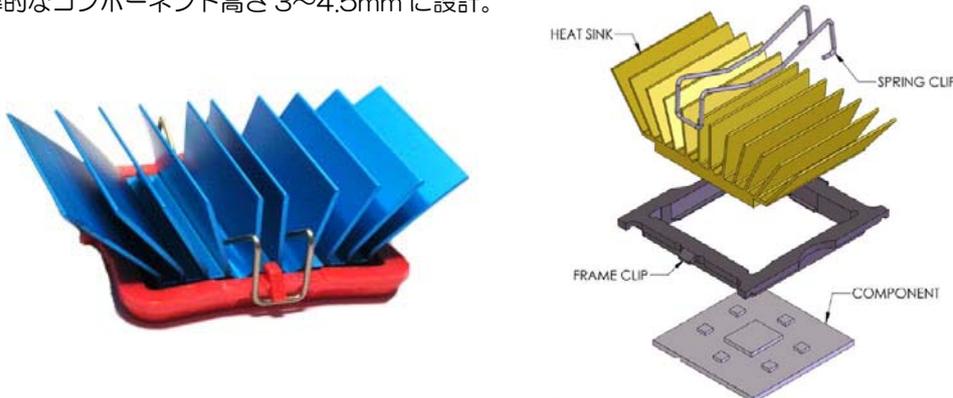
- *ロープロファイルで、より効果的な放熱冷却のために、表面積を最大化したスプレッドフィン。
- *簡便なスーパーグリップ™ 取り付け方式により、PCB 基板に孔加工不要でしっかりと BGA に圧着。
- *高密度 PCB 設計においても、コンポーネント周囲に最小化した取り付けスペース。
- *衝撃や振動のある環境下でも、強固で安全な取付けを提供。
- *取付け取外しが簡単で、より高機能化のために相転移や熱伝達材料の検討が容易に可能。



マキシフローHeat Sink マキシグリップ型クリップアタッチメント方式

主な特徴：

- *ロープロファイルで、より効果的な放熱冷却のために、表面積を最大化したスプレッドフィン。
- *簡便なマキシグリップ™ 取り付け方式により、PCB 基板に孔加工不要でしっかりと圧着。
- *Telcordia GR-6 Core, ETSI 300 019; MIL-STD-810（米軍規格）の衝撃及び標準振動試験に準拠。
- *取付け取外しが簡単で、より高機能化のために相転移や熱伝達材料の検討が容易に可能。
- *標準的なコンポーネント高さ 3~4.5mm に設計。



PCB基板に穴加工を必要とせず、クリップでBGAに直接固定が出来ます。
BGAにダメージを与えることなく、取付け取外しが可能です。
※適合BGA寸法及び放熱性能は別紙リストとデータシートをご参照下さい。

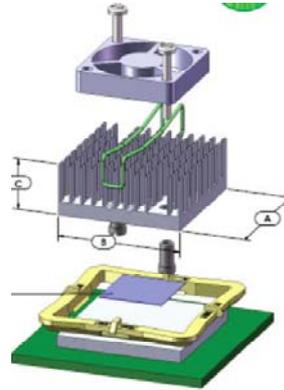
ATS 社ヒートシンク 販売代理店：有限会社シスコム 営業技術部

〒171-0014 東京都豊島区池袋 4-27-5 和田ビル TEL:03-6907-9105 FAX:03-6715-8740

E-mail: Syscom@corp.email.ne.jp Web: <http://www.syscom-corp.jp>

ATS ファンシンク マキシグリップ型クリップアタッチメント方式

- *PCB レイアウトとは独立して最適な放熱機能を保証する全方向エアフロー。
- *ステンレス製ネジによる取り付けで、信頼性のある長期間のファンとヒートシンク組立が可能。
- *ATS 社のマキシグリップは、高信頼性が証明されたメカニカル式の取り付け方式。
- *簡便なマキシグリップ™ 取り付け方式により、PCB 基板に孔加工不要でしっかりと圧着。
- *事前に取り付ける熱伝達材料も一緒に供給。



PCB基板に穴加工を必要とせず、クリップでBGAに直接固定が出来ます。
BGAにダメージを与えることなく、取付け取り外しが可能です。
※適合BGA寸法及び放熱性能は別紙リストとデータシートをご参照下さい。

別紙資料サイト：

マキシフローHeat Sink
スーパーグリップ型クリップアタッチメント方式

<http://syscom-corp.jp/doc/product/heatsink/supergrip.html>

マキシフローHeat Sink
マキシグリップ型クリップアタッチメント方式

<http://syscom-corp.jp/doc/product/heatsink/maxigrip.html>

ATS ファンシンク
マキシグリップ型クリップアタッチメント方式

<http://syscom-corp.jp/doc/product/heatsink/fansink.html>

製品の御見積や詳細及び、その他製品のお問合せは
ATS ヒートシンク 販売代理店 有限会社シスコムまでお問合せ下さい。

ATS 社ヒートシンク 販売代理店：有限会社シスコム 営業技術部

〒171-0014 東京都豊島区池袋 4-27-5 和田ビル TEL:03-6907-9105 FAX:03-6715-8740

E-mail: Syscom@corp.email.ne.jp Web: <http://www.syscom-corp.jp>